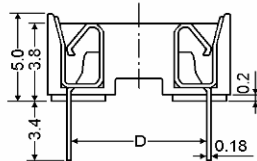
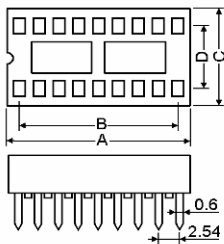
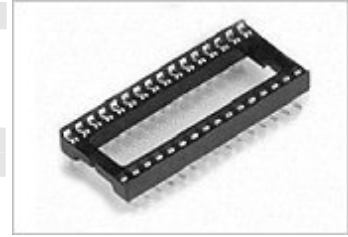


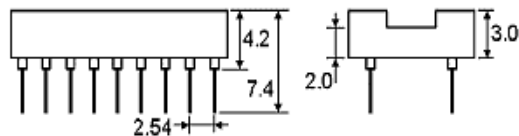
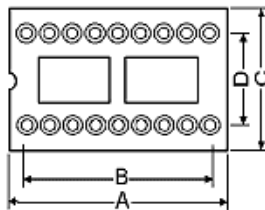
Панели под микросхемы в корпусах DIP
шаг 2.54 мм
Основные характеристики:

Материал	контактов	фосфорная бронза, олово или золото поверх никеля
	корпуса	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0
Предельные	ток	1А
	напряжение изолятора	1000 В в течение 1 мин. Не менее 1000 МОм
Сопротивление	контактов	не более 2×10^{-2} МОм для олова не более 10^{-2} для золота
	сочленение	не более 140 гр.
Усилие	расчленение	не более 75 гр.
	Допустимые температуры	-55 - + 105°C



		SCS								
		8	14	16	18	20	22	24	28	32
A		10,1	17,7	20,1	22,8	25,3	27,8	30,3	35,5	40,6
B		7,62	15,24	17,78	20,32	22,86	25,40	27,94	33,02	38,10
C		9,9								
D		7,62								

		SCL								
		24	28	32	36	38	40	42	48	
A		30,4	35,5	40,6	45,6	48,3	50,7	53,3	61,0	
B		27,94	33,02	38,10	43,18	45,72	48,26	50,80	58,42	
C		17,6								
D		15,2								

Панели под микросхемы в корпусах DIP, цанговые
шаг 2.54 мм


Тип	SCSM					
Размер	8	14	16	18	20	24
A	10,2	17,8	20,2	22,8	25,4	30,43
B	7,62	15,24	17,78	20,32	22,86	27,94
C	10,1					
D	7,62					

SCLM			
24	28	32	40
30,5	35,6	40,7	50,8
27,94	33,02	38,1	48,26
17,7			
15,2			